

# 公司概況資料表

以下資料由博盛半導體股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

風險事項說明(申請登錄戰略新板公司適用)

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：博盛半導體股份有限公司 (股票代號：7712)

申請登錄：一般板 戰略新板

董事長	孟祥集
總經理	孟祥集
資本額	新台幣294,238,730元
輔導推薦證券商	兆豐證券股份有限公司 合作金庫證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	兆豐證券股份有限公司 袁先生(03)666-2898 分機502
註冊地國	該公司非屬外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	該公司非屬外國發行人，故不適用

輔導推薦證券商認購博盛半導體股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	兆豐證券股份有限公司	合作金庫證券股份有限公司
認購日期	112年11月15日	

認購股數 (股)	549,000股	40,000股								
認購占擬 櫃檯買賣 股份總數 之比率	1.87%	0.14%								
認購價格	每股新台幣80元									
認購價格 之訂定 依據及方 式	<p>一、認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之承銷價格，作為博盛半導體股份有限公司(以下簡稱博盛半導體或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。</p> <p>二、承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較，目前股票價值評估方法眾多，各方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前常用之股票評價方法主要包括：</p> <p>(1)市價法：本益比法(P/E ratio)或股價淨值比法(P/B ratio)，均透過已公開的資訊與整體市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業之價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整。</p> <p>(2)成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。</p> <p>(3)現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值評定之基礎。</p> <p>以上股票評價方法：成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比較適用於獲利不穩定，或產業成熟但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。</p> <p>三、發行人與已上市櫃同業之本益比之比較情形</p> <p>該公司主要業務為 IC 設計開發、應用服務及銷售，為半導體產業上游之專業 IC 設計公司，主要產品為：(1)功率半導體元件中的功率金屬氧化物半導體場效電晶體(Power Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, Power MOSFET)，其相關產品應用領域為消費性電子產品如:智慧型手機、平板及筆記型電腦與儲能設備及車用電子。經參酌與該公司目前之產品服務或營運模式較相似之上市櫃公司有富鼎(8261)、大中(6435)、杰力(5299)及尼克森(3317)，故選擇前開公司為比較之同業。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>公司別</th> <th>主要營收項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富 鼎(8261)</td> <td>主要從事功率半導體 Power MOSFET 研究、開發、生產、測試及銷售</td> </tr> <tr> <td>大 中(6435)</td> <td>主要從事研究、設計、製造及銷售功率半導體元件及模組、高壓積體電路及模組</td> </tr> <tr> <td>杰 力(5299)</td> <td>主要從事功率元件、電源管理積體電路及電源模組之</td> </tr> </tbody> </table>		公司別	主要營收項目	富 鼎(8261)	主要從事功率半導體 Power MOSFET 研究、開發、生產、測試及銷售	大 中(6435)	主要從事研究、設計、製造及銷售功率半導體元件及模組、高壓積體電路及模組	杰 力(5299)	主要從事功率元件、電源管理積體電路及電源模組之
公司別	主要營收項目									
富 鼎(8261)	主要從事功率半導體 Power MOSFET 研究、開發、生產、測試及銷售									
大 中(6435)	主要從事研究、設計、製造及銷售功率半導體元件及模組、高壓積體電路及模組									
杰 力(5299)	主要從事功率元件、電源管理積體電路及電源模組之									

	研究、開發、設計、製造及銷售。
尼克森(3317)	主要從事類比積體整合電路產品之設計及行銷等業務

資料來源：各公司111年度年報

採樣同業	本益比			
	112/8	112/9	112/10	平均
富 鼎(8261)	22.50	22.25	23.72	22.82
大 中(6435)	18.28	20.55	20.58	19.80
杰 力(5299)	15.66	17.29	17.50	16.82
尼克森(3317)	13.49	15.22	16.11	14.94
上市半導體類股	15.11	14.61	15.08	14.93
上櫃半導體類股	21.13	21.52	22.20	21.62

資料來源：證交所及櫃檯買賣中心

該公司之採樣同業及上市櫃半導體類股於112年8至10月之平均本益比約介於14.93~22.82倍之間，依據該公司111年度及112年上半年度經會計師查核或核閱之財務報告，設算該公司最近四季(111年第三季至112年第二季)之稅後淨利為198,169千元，以該公司目前股本29,424千股設算之最近四季每股稅後盈餘為6.73元，並考量興櫃市場之流動性風險貼水而採七折計算，其每股合理價格區間為70.34元~107.51元，議定推薦證券商股票認購價格為80元，介於每股合理價格區間內，故議定之認購價格尚屬合理。

#### 四、推薦證券商就其與發行人所共同議定承銷價格合理性之評估意見。

綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定係參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並考量該公司之所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之興櫃每股認購價格，尚屬合理。

### 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

#### 【公司介紹】

博盛半導體股份有限公司成立於民國103年，主要從事業務為功率元件(Power Devices)、電源管理積體電路及驅動(Power Management ICs & Driver ICs)及電源模組(Power Modules)的設計、研發、製造、銷售及整合，其產品已取得 ISO-9001、ISO-14001等多項國際認證，並可廣泛應用 PC/NB 消費性電子、5G 通訊系統、工業控制系統、綠能設備、汽車應用領域及雲端資料中心等相關領域。

#### 【歷史沿革】

年 度	重 要 紀 事
103年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 103年4月30日核准設立，實收資本額為新臺幣8,000千元。</li> <li>● 設立於新竹縣竹北市嘉豐十一路二段33號4樓。</li> </ul>
104年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO9001認證通過。</li> <li>● 經濟部 SBIR 科專計畫通過。</li> <li>● 第一項專利申請通過。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受邀工研院科技新創發表會並獲邀為第一屆科技新創俱樂部會員。</li> <li>● 全年公司正盈餘目標達成。</li> </ul>
105年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受邀參與中科院軍民通用高功率元件研發聯盟。</li> <li>● 獲頒第13屆金炬獎最佳潛力公司暨最佳潛力經理人獎。</li> <li>● 年營業額突破新台幣二億元。</li> </ul>
106年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 獲頒第18屆金峰獎傑出企業獎。</li> <li>● 年營業額突破新台幣四億元。</li> </ul>
107年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 購入竹北高鐵站前總部現址。</li> <li>● 年營業額突破新台幣八億元</li> </ul>
108年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 開發出業界高集成度6合1 MOSFET。</li> <li>● 開發出超高電壓1,500V MOSFET 並導入量產。</li> <li>● 第一顆車規 MOSFET 獲認證通過。</li> <li>● 獲頒華人公益節「公益大使」。</li> <li>● 獲頒第二十二屆小巨人獎。</li> </ul>
109年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 榮登中華徵信所調查「台灣地區前5000大企業」。</li> <li>● 獲頒第七屆鄧白氏中小企業菁英獎。</li> </ul>
110年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 榮登中華徵信所調查「台灣地區前5000大企業」，積體電路設計第51名。</li> </ul>
111年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO14001認證通過。</li> <li>● 榮登中華徵信所調查「台灣地區前5000大企業」，積體電路設計第52名。</li> <li>● 年營收突破新台幣十七億元。。</li> <li>● 博盛半導體研發中心於竹北舉行動土典禮。</li> </ul>
112年	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 榮登中華徵信所調查「台灣地區前5000大企業」，積體電路設計第44名。</li> </ul>

### 【經營理念】

博盛半導體成立迄今已取得臺灣、美國和日本多項發明專利，期待用最好的產品與技術打動客戶的心，不僅在泛用型功率元件推出高品質產品且規畫海外市場布局外，也積極開發前瞻性技術。10年來孟祥集董事長帶領團隊，秉持「以科技促進每天的生活，做出令人感動的產品，做出令人感動的服務」為使命，開發具競爭力的產品和執行差異化的行銷策略，在業界站穩一席之地。未來仍堅持落實根留臺灣，持續為保護環境和地球永續盡一份心。

### 【未來展望】

#### (1)短期業務發展計畫

- 加速國際級一線客戶的建立：透過一線客戶的實地稽核，可以快速累積公司在「質」的專注和一致性，同時達到出貨穩定，風險控管的目的。
- 加速第三代半導體 SiC、GaN 的推廣：目前鎖定韓國、日本、印度、歐洲等地區重點推廣工業用及車用領域，本公司目前計劃在未來三年內增加第三代半導體的銷售份額，使其在公司整體銷售總額中占有重要地位。
- 加速車規客戶推廣：目前車規 MOSFET 佔公司整體銷貨總額10%，計劃在未來三年內實現顯著的增長，達到年出貨量超過一億顆車規 MOSFET 的目標。
- 透過期刊、論文、書籍及專利的發表加速全球客戶認識博盛及傳遞我們的技術研發及應用理念。

## (2)長期業務發展計畫

- A. 加速全球代理商的佈建：讓世界各地的用戶都看得到博盛，這一直都是我們堅持的理念。博盛在六年前增設了海外辦公室，直接隸屬於總經理室，目標佈建40個國家、150間以上代理商的綿密網絡深耕全球客戶。
- B. 本公司於竹北購地自建研發中心，完工後將成為本公司發展汽車電子的中樞，所有相關的檢測、試驗、認證及可靠度都將在此研發中心完成，希冀成為全球車用客戶優質供應鏈的一環。同時為加強生產及品質管控，本公司在同址亦成立現代化的倉儲物流空間，配備高規的溫濕度及潔淨度管控，同時導入最先進的RFID 自動化倉儲管理系統，讓所有的進出貨符合快速、效率、正確的原則，以迎接國際級客戶的要求與挑戰。
- C. 為因應本公司加速國際化的腳步，擬在台北南港置辦商辦一層做為本公司國際級業務中心，專責重要客戶及國際級客戶之訪問、考察、稽核、交流等事宜。因位於南港高鐵站旁，交通便捷，方便本公司竹北總部支援，可提升本公司國際視野，加速與世界商務的擴容。

### 風險事項說明(登錄戰略新三板公司適用)

博盛半導體係依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第三章規定申請股票登錄戰略新三板之公司，相關營運風險較高，且戰略新三板市場參與者之買方限合格投資人，請投資人特別注意。

#### 產業風險

功率半導體應用於所有的電子產品，其特性及使用會影響系統整體的電源轉換效率，隨著電子產品能效規範的提升要求，其重要性持續增加。但，功率半導體產業仍有受總體經濟、消費性終端需求及供應鏈庫存水位的短期波動影響，惟長期發展與成長動能仍屬可期。

#### 營運風險

本公司為專業 IC 設計公司，IC 設計完成後需委由專業晶圓製造廠代工製造，並交與後段封測廠進行封裝測試，故若晶圓製造及封測廠之生產技術之配合，可能直接影響產品品質及成本，進而影響獲利水準。另，功率半導體 IC 設計業屬於腦力密集之產業，其相關研發人員之養成及訓練皆需長期培養，能掌握高素質的研發人員，將是 IC 設計公司的核心競爭力，故研發人員的異動將對公司的營運產生影響。

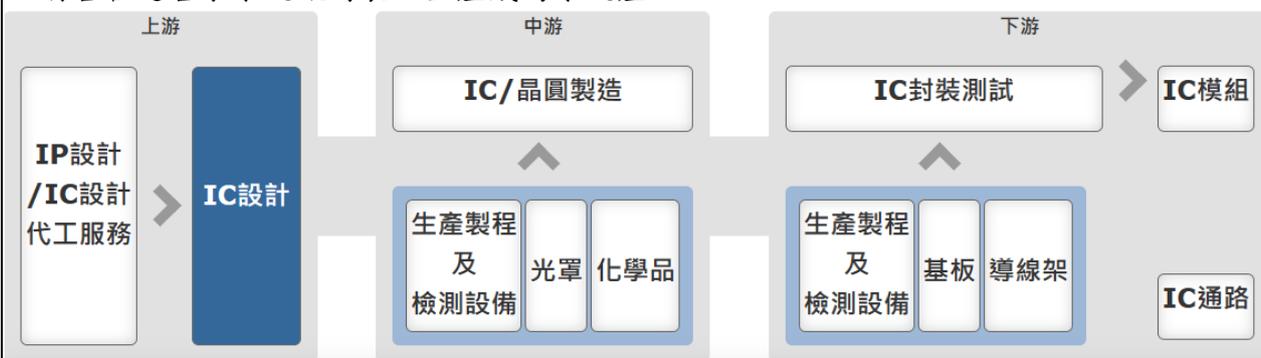
TOP ^

**主要業務項目：**

該公司主要業務為 IC 設計開發、應用服務及銷售，為半導體產業上游之專業 IC 設計公司。

**公司所屬產業之上、中、下游結構圖：**

半導體產業鏈上游為 IP 設計及 IC 設計業，中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等產業，下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC 模組、IC 通路等業。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC 設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠或 IDM 廠（整合型半導體廠，從 IC 設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
功率半導體 元件		主要用途為接受訊號控制來調節電壓並承受電流的半導體元件，並大量應用於電源供應器、變頻驅動器、電機控制器、太陽能逆變器等。其被廣泛使用於日常消費性產品(Consumer)、工業類產品(Industrial)、通訊類產品(Telcom)、醫療(Medical)及車用(Automotive)等產品上。	1,711,188	100.00
合 計			1,711,188	100.00

TOP ^

**最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年 (註1)	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	112年截 至9月份止 (自結數)(註2)
營業收入		821,493	849,753	915,934	1,363,616	1,711,188	1,009,896
營業毛利		181,094	144,781	148,797	353,666	518,481	282,962
毛利率(%)		22.04	17.04	16.25	25.94	30.30	28.02
營業外收入		5,280	586	3,249	3,564	69,721	38,945
營業外支出		(2,232)	(8,088)	(3,962)	(3,262)	(5,309)	(4,840)
稅前損益		85,270	28,443	85,487	229,766	357,380	187,943
稅後損益		64,482	13,008	69,804	190,080	280,175	127,140
每股盈餘(元)		7.24	0.91	3.65	8.40	11.97	4.32
股利 發放	現金股利(元)	0.7	0.58	1	1.5	—	—
	股票股利(資 本公積轉增 資)(元)	—	—	—	—	—	—
	股票股利(盈 餘轉增資)(元)	3.86	—	—	—	1.46	—

(註1)上列各年度財務資料經會計師查核簽證；107年度至109年度未編製合併報表，故僅揭露個體數字。

(註2)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

### 最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		107年 (註)	108年 (註)	109年 (註)	110年 (註)	111年 (註)
項目						
流動資產		479,117	449,210	664,161	1,071,072	1,253,475
基金及長期投資		—	—	—	—	—
固定資產		63,376	58,969	52,152	120,536	220,233
無形資產		—	—	580	290	—
其他資產		327	4,473	67,031	6,644	233,692
資產總額		542,820	512,652	783,924	1,198,542	1,707,400
流動 負債	分配前	281,206	205,631	365,628	528,469	565,349
	分配後	290,116	216,631	384,752	557,155	565,349
長期負債		66,298	82,852	65,692	97,582	181,462
其他負債		—	2,016	71,947	121,134	124,158
負債 總額	分配前	347,504	290,499	503,267	747,185	870,969
	分配後	356,414	301,499	522,391	775,871	870,969
股本		127,292	191,239	191,239	191,239	239,239
資本公積		492	8,408	8,408	8,408	92,888
保留 盈餘	分配前	67,532	22,506	81,310	252,266	503,755
	分配後	9,498	11,506	62,186	223,580	468,755
長期股權投資 未實現跌價損失		—	—	—	—	—
累積換算調整數		—	—	(300)	(556)	549
股東權益 總額	分配前	195,316	222,153	280,657	451,357	836,431
	分配後	186,406	211,153	261,533	422,671	836,431

(註)上列各年度財務資料經會計師查核簽證；107年度至109年度未編製合併報表，故僅揭露個體數字。

TOP ^

### 最近三年度財務比率

年度		109年	110年	111年
項目				
財務 比率	毛利率(%)	16.25	25.94	30.30
	流動比率(%)	181.65	202.67	221.72
	應收帳款天數(天)	39.68	30.95	35.38
	存貨週轉天數(天)	63.81	72.85	85.08
	負債比率(%)	64.20	62.34	51.01

(註1)上開110年度至111年度財務資料均經會計師查核，109年度未編制合併財務報告，故以個體數字計算。

TOP ^ 投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至 [公開資訊觀測站!!](#)